

2020年3月期第2四半期決算説明会 質疑応答要旨

参考資料:2020年3月期第2四半期決算説明会資料

(補足) PKG : パッケージ基板

HDI(High Density Interconnect) : マザーボードに使われる高密度実装基板

サブトラクティブ工法(サブトラ) : 一般銅箔を使用して回路を形成する工法

MSAP工法 : 当社の極薄銅箔MicroThin™を使用して回路を形成する工法

L/S(Line & Space) : 回路の線幅の細さおよび回路間のスペース

【全社】

- Q. 御社は非鉄の他社と比べ、多くの事業を抱えている印象がある。他社は得意でない事業を売却するなど、集中と選択を進めるような動きも見られるが、御社は機能材料等に集中して投資していくために、選択と集中を進めて経営資源を集中させていくという方向性はないのでしょうか
- A. ご指摘の通りだと思う。16中計の時から新規事業への取り組みとして、コーポレートベンチャーキャピタルや固体電解質、GPF触媒等、新しい投資案件が出てきている一方で、製品の入れ替えを行い、経営資源の再分配や見直しに取り組んでいる。今ここで具体的にお話しできる材料はないが、今後そのようなお話ができる機会があると思う

【機能材料セグメント】

- Q. HDI向けMicroThin™について、顧客が拡大していくというシナリオだったと思うが、なかなか採用が進まない背景、今年度お客様の採用が一部見送られた件等を含めて、HDI向けMicroThin™についてご説明下さい
- A. HDI 向け MicroThin™の採用がなかなか先に進まない理由としては、L/S=30/30 を切るとMSAPが優位になるが、現在はちょうど端境期にあるようだ。
お客様の採用状況については、韓国メーカーは、来年度の主力 2 機種のうち 1 機種はサブトラでやる事が決まっており、もう 1 つの機種は現在 MicroThin™を採用するか検討中。こちらもL/S=30/30 辺りの話のため、どちらになるか分からない状況。
中国メーカーは大手 2 社が MSAP 採用を検討中。そのうちの 1 社は来年度の主力の 2 機種について MSAP を検討しているが、まだ決定していない。もう 1 社の中国メーカーも、MSAP 検討中の段階。
足元は当初の計画の約半分しか売れていない。減少した要因の内訳は、採用層数の減少が 50%弱。韓国メーカーや中国メーカーの採用遅れが 20%弱程度。スマホ販売減の影響が 10%強。顧客の生産効率化で 10%強。国内競合による影響は約 9%と推定している。
来年度については、北米メーカーから 5G スマホが発売され、HDI 向け MicroThin™は面積ベースで設計上 25~30%程度増えると聞いている。また L/S は現時点では来年度は L/S =30/30、再来年度は L/S=25/25 の見込みと聞いている。
- Q. HDI向けMicroThin™について、L/Sが当初の見込みよりもなかなか小さくならない原因は、どのようにお考えでしょうか。北米メーカー向けの層数は減っているとのことなので、再来年度のL/Sの話についても確信が持てない
- A. 設計がファインの方に進まないのは、MicroThin™を使う層数を減らそうとしているためだと思う。現在は、出来る限りトータルコストを下げながら性能を出すことができているが、5Gになると部品搭載点数が増える事もあり、ファインになってくるのは間違いない。また、北米メーカーもトレンドとしてはL/S=25/25を想定しており、それに向けたMicroThin™の開発は既に終わり、お客様評価も終わっている。本格的な5Gになる頃には使われてくるだろうと思っている

- Q. 来年度の北米メーカーのHDI向けMicroThin™が面積ベースで25～30%程度増える背景を教えてください
- A. ファイン化が進むわけではなく、L/S=30/30で設計される予定だが、基板が大きくなって形が変わるため、基板面積が増えることがベース。基板サイズが大きくなることで1枚のMicroThin™から取れる基板数が減り、結果的にMicroThin™使用量が増えるとの話があったが、結果は実際のスマホを分解してみないと分からない
- Q. 昨日の電話会議で韓国スマホの来年度モデルにHDI向けMicroThin™が採用を見送られた理由として日韓貿易問題による調達リスクというご説明があったが、今後の採用についてはどうか
- A. 韓国ユーザーは、多少無理をしてもMicroThin™を使わないサブトラ工法や日本製を使わないという方針になってきている。ただし日本製以外が採用されるかどうかは評価次第であり、まだわからない
- Q. HDI向けMicroThin™について競合が入ってきた理由をお聞かせください。また、来年の単価の見込みについてもお聞かせ下さい
- A. 競合が入ってきた理由は、一社独占はできるだけ避けたいというお客様の考えだと思う。価格については、特に競合が入ってきたからといって今までの方針に変更はない
- Q. ハイエンドの一般銅箔は調子がよさそうだが、こちらの背景と来年以降の見通しを教えてください
- A. 2018年、2019年の通信インフラ用銅箔については、急激に増加し好調が継続している。またハイエンドだけでなくミドルレンジも非常に好調。台湾銅箔もマレーシア銅箔も通信インフラ用銅箔をフル生産しており、通信インフラ向けではこの状況がしばらく続くとお客様からは言われている
- Q. 5G 関連市場向けのハイエンド銅箔は好調ですが、マレーシア工場の稼働率について、MicroThin™とそれ以外をそれぞれどのくらい作っているのでしょうか。また余っているキャパに対し、PKG 向けへの生産シフトが早い段階で始まるのか等、今後の見方について教えてください
- A. 一般箔については通信インフラ用で、台湾で作りきれないものをマレーシアで作っており、ほぼフル生産の状態。一方MicroThin™については、キャパは埋まっておらず、稼働率は2割程度。空いたキャパで行っていることは2つある。1つは製造コストを更に下げたため、キャリア銅箔を18μから12μに変えた製品を上市した。もう1つは、間違いなく増えるPKG向けMicroThin™をマレーシアで安定生産できるようにし、一部のお客様では認定が終わっている状況
- Q. 全固体電池について、新しい動きがあったら教えてください。また、どのようなスケジュールでどれくらいの量なのか等、見えてきたことがあれば教えてください
- A. 車載向けは、40kg/月のキャパを150kg/月程度にした。更に、現在パイロットプラントを建屋から設計中であり、11月末までには設計が完了する。その時の進捗状況を見て、パイロットプラントを建てるかどうか今後検討する。新しい話としては、高真空、高温、極低温というような特殊用途として当社の固体電解質がマクセル様に採用された。こちらは既にマクセル様がお客様にサンプルを配って評価されており、来年度から量産開始となるようだ
- Q. マクセル向けの量産供給に関しては、設備の能力的に問題はないのでしょうか
- A. マクセル様の電池はウェアラブルのようなコイン型電池であり、今の設備で十分作れる。これが収益に与える影響は大きくはないが、硫化物系の固体電解質が世の中に量産で出るといふインパクトの方が大きいと思う

- Q. ITOターゲットの抜本的な構造改革が必要かどうか検討中とのことでしたが、方向性などでお話しできることがあればお聞かせください
- A. ITO ターゲットのお客様に変化があった。現在は中国勢が大型工場を建てて非常に強くなってきており、台湾、韓国のお客様の立場が弱くなっている。当社としては、我々の強みをしっかりと活かしながら効率的にどのように事業運営していくかについて、来年の3月までに構造改革案を出す
- Q. 機能材料向けの設備投資を計画より減らすとのことですが、具体的な内容を教えて下さい
- A. 大きいものは、アトマイズ銅粉のラインを下関に作る計画の一部を延期する。その他、薄膜材料についても投資を抑える予定。一方、研究開発については手を緩めることはない

以上